



NXP와 이씨스, 국내 첫 차세대 지능형교통시스템 시범 사업 참여

- 세종-대전간 차세대지능형교통시스템에 로드링크 칩셋 제공
- 시큐어 솔루션으로 높은 신뢰도의 통신 연결 제공

2016년 7월 13일, 서울 -NXP반도체(NASDAQ: NXP)와 이씨스(대표이사: 김용범, <http://essys.co.kr>)는 국토부가 추진하는 국내 첫 '차세대지능형교통시스템(이하 C-ITS)' 시범 사업에 공동 참여한다고 밝혔다.

NXP는 차량간/차량대인프라 통신(V2X) 솔루션인 로드링크(RoadLink) 칩셋을 국내 자동차 전장 시스템 전문 기업인 이씨스의 웨이브 통신 솔루션에 탑재함으로써 C-ITS 시범 사업에 참여하게 된다. 전세계적으로 다양한 프로젝트를 통하여 이미 검증받은 NXP의 V2X 전문성이 이씨스의 C-ITS 솔루션에 포함됨에 따라 시범 사업의 완성도를 높이는데 크게 기여할 것으로 기대된다. 특히 높은 보안 수준의 NXP 시큐어 솔루션은 해킹에 대한 우려없이 보안 연결을 구현할 수 있어 높은 신뢰도를 제공한다.

이번 시범 운행은 2016년 7월부터 2017년 7월까지 세종~대전 지역 도로 총 87.8km에 달하는 구간에서 진행된다. 현재 전국 고속도로에 설치된 기존 ITS는 센터 중심으로 정보를 제공하므로 돌발 상황에 대한 신속한 대응이 늦다는 한계가 있다. 반면 새로 도입되는 C-ITS는 도로 및 차량간 통신 시스템을 통해 개별 차량이 실시간으로 정보를 제공할 수 있게 함으로써, 돌발 상황에 대한 사전 대응 및 예방이 가능하다.

V2X 기술은 코너 반대 쪽이나 운전자 시야 밖의 교통 방해물 전방까지 확인할 수 있어 도로 안전성을 높이고 CO2 배출을 줄이며 원활한 교통 흐름을 지원한다. 경찰청에 따르면, 매년 5,000명 이상이 교통사고로 사망하며, 30만 명 이상이 부상을 당한다. 교통 혼잡은 매년 약 31조원 이상의 비용을 유발하고 있다. 한국교통연구원은 C-ITS가 완전히 도입된다면 전체 교통 사고의 76% 가량을 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있다.

이씨스의 김용범 대표이사는 "자동차 전장 시스템 전문 기업인 이씨스는 자동차 제조사와 기술 공급업체에게 더욱 경제적인 최적의 성능을 구현할 수 있는 통신 모듈을 제공하기 위해 노력하고 있다. 전세계에서 검증된 NXP의 로드링크 칩셋이 탑재된 이씨스의 웨이브 통신 솔루션은 C-ITS 사업에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

NXP는 이미 전세계 각지에서 V2X 솔루션을 제공하고 있다. 최근에는 미 교통부의 스마트 시티 챌린지에 선정된 미국 오하이오주 콜럼버스에 지능형 교통관리 시스템을 제공하고 있으며, 지난



4월에는 네덜란드 인프라 및 환경부가 주최한 ‘유럽 트럭 플래투닝 챌린지(European Truck Platooning Challenge)’에서 V2X 기술을 활용해 트럭의 자율 주행 기술을 성공적으로 시연한 바 있다.

자율주행 차량 및 거시적인 교통 관리를 지속적으로 개발하고 선진화하기 위해 NXP의 로드링크 V2X 커뮤니케이션 및 보안 기술은 필수적이다. 이 기술은 인근 차량끼리 무선으로 속도, 위치, 방향 등에 대한 정보를 교환하고, 차량과 인프라간에 교통 통제 데이터나 속도 제한 구역, 교통 신호, 도로 작업 경고, 위험 구역과 같은 위험을 알려준다. 보안 요소는 칩셋의 일부로 통합되어 있으며, 해킹이나 조작의 위험으로부터 운전자의 프라이버시를 보호해준다.

NXP반도체 신박제 회장은 “전세계에서 인정받고 있는 NXP의 V2X 솔루션인 로드링크 칩셋이 국토부의 차세대지능형교통시스템에 채택되어 영광으로 생각한다. 이번 시범 사업을 통해 한국의 ITS 기술 발전에 NXP가 도움이 되길 희망하며, 이를 통해 축적되는 또 다른 경험은 NXP가 더욱 안전하고, 원활하며, 쾌적한 교통을 만들어, 사고를 예방하고 생명을 지킬 수 있는 기술을 제공하는 데 큰 도움이 될 것으로 생각한다”고 밝혔다.

NXP는 지멘스(Siemens), 하만(Harman), 델파이(Delphi), 코다 와이어리스(Cohda Wireless) 등 주요 업체 및 차량 OEM 업체들과 V2X 기술에 대해 협력하고 있다.

이씨스(eSSys) 소개

자동차 전장 시스템 전문 기업인 이씨스는 텔레매틱스, AVN, ETCS, 블루투스, 와이파이 및 차세대 통신 WAVE(V2X) 등 전장 핵심 부품을 개발, 생산하고 있으며, 고객사에게 경제적이고 최적의 성능이 구현되는 통신 모듈을 제공하고 있다. 2005년 설립 이후 전장용 DSRC 칩 등 원천 통신기술 국산화에 앞장서 온 이씨스는 경쟁력 있는 제품을 개발하는 데 역점을 두고 있으며, WAVE 등 차세대 ITS 기술 확보, 고속 무선통신 기술 선도, 멀티미디어 분야의 진입 및 성장, 그리고 최첨단 텔레매틱스 분야의 개발 및 생산 전문 기업으로 성장하기 위해 지속적인 투자를 하고 있다. 이씨스에 대한 보다 자세한 정보는 www.essys.co.kr에서 확인할 수 있다.

NXP 반도체 소개

NXP 반도체 (나스닥: NXPI)는 스마트 월드를 위한 시큐어 커넥션 기술을 제공한다. NXP는 임베디드 애플리케이션 용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 35개 이상의 국가에서 44,000명의 직원을 고용하고 있으며, 2015년 61억 달러의 매출을 기록했다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.